

A

B

C

D

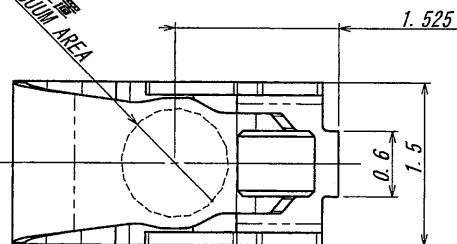
E

F

G

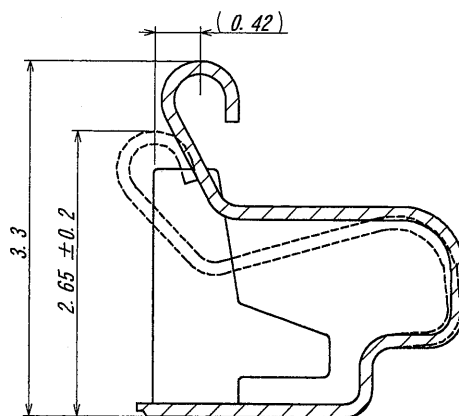
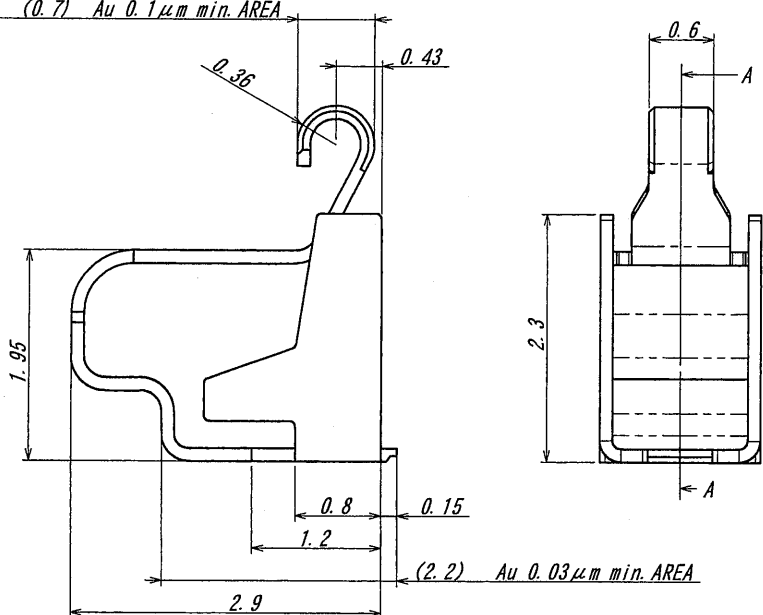
H

φ1 吸着位置
VACUUM AREA



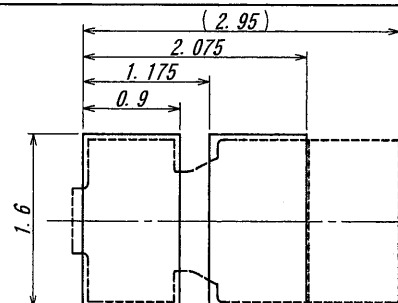
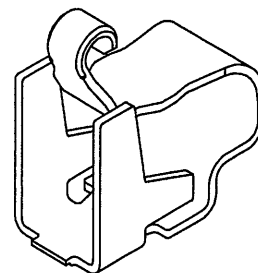
(0.7) Au 0.1μm min. AREA

0.36 0.43



NOTE

1. 使用範囲 : 接点高さ 2.65 ± 0.2
USE LOCATION : CONTACT HEIGHT 2.65 ± 0.2
2. 接触圧力 : 1.0 ± 0.3N/2.65mm
CONTACT PRESSURE : 1.0 ± 0.3N/2.65mm



推奨基板/RECOMMENDED PCB
一般公差/GENERAL TOLERANCE : ± 0.05

ISSUED

'14.7.18

IRISO
ENG. DEPT.

MATERIAL 材質

チタン銅/TITANIUM COPPER
(t=0.12)

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.2
ANGLE 角度 ±

SCALE
尺度

DR '14-7-17
Y. Hayashi

CHK 3/17 M. Takagi

UNIT
単位

mm

DSN '07-10-12
Y. Ogura

APP 3/17 M. Takagi

TITLE 名称

4076シリーズ コンタクト
SERIES 4076 CONTACT

EDP No

PARTS No 部番

IPS-4076T-01B-GF

DWG No 図番

110-104076-002

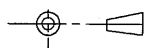
REV.

2

FINISH 仕上げ

前めっき/PRE-PLATE
Ni下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.3μm MIN.
金めっき/Au PLATE: 接点部/CONTACT AREA: 0.1μm MIN.
: チ-尾部/TAI AREA: 0.03μm MIN.

3RD. ANG. PROJ. 三角法



IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリス電子工業株式会社